股票简称:力芯微　　股票代码:688601

无锡力芯微电子股份有限公司

Wuxi ETEK Microelectronics Co., Ltd.

无锡新区新辉环路8号

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构(主承销商)

光大证券股份有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD.

(上海市静安区新闸路1508号)

二〇二一年六月二十五日

特别提示

无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“力芯微”、“发行人”、“公司”或“本公司”）股票将于2021年6月28日在上海证券交易所科创板上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

本公司股票将于2021年6月28日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。公司就相关风险特别提示如下:

（一）涨跌幅限制放宽

科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在科创板上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%。上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板的新股上市首日涨幅限制44%,上市首日跌幅限制36%,次交易日开始涨跌幅限制为10%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。

（二）流通股数量较少

本次发行后,公司总股本为6,400.0000万股,其中上市初期无限售条件流通股票数量为1,302.6658万股,占发行后总股本的20.35%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

（三）市盈率高于同行业平均水平

本次发行市盈率为44.31倍（每股收益按照2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。截至2021年6月10日(T-3日),中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业(分类代码:C39)”最近一个月平均静态市盈率为41.95倍。本次发行市盈率高于同行业平均水平,未来可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）融资融券风险

科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,并认真阅读招股说明书“第四节风险因素”章节的全部内容。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素:

（一）市场竞争风险

公司产品主要应用于手机、可穿戴设备等领域,市场规模大且下游产品更新较快,市场化竞争激烈。公司的市场策略主要定位于下游知名客户,在新客户开发、维护现有客户合作关系并保持产品出货量及新品推广的同时,也面临着来自国内外竞争对手的竞争。

在国际市场中,公司在特定领域与TI、ON Semi、DIODES、Richtek等全球知名IC设计公司直接竞争,但在市场地位、整体技术实力、销售规模、产品种类齐全性等方面存在一定差距;在国内市场中,近年来消费电子市场的发展吸引了众多国内优秀的IC设计公司参与,也产生了一定的市场竞争。公司与国内外竞争对手在市场地位、经营规模、产品数量等方面的对比如下:

公司名称	市场地位	经营规模	产品数量
TI	全球领先的模拟及数字半导体芯片设计制造公司，电源管理芯片包括全线电源管理产品,应用领域非常广泛,市场占有率全球第一	102.2亿美元	超过8万款
ON Semi	一家电源管理集成电路和标准半导体等产品的供应商，在PC内核电源、线性稳压器具备领先地位	17.4亿美元	未披露
DIODES	在分立和模拟半导体市场上居全球领先地位	12.49亿美元	超过25万款
Richtek	一家国际级的模拟IC设计公司	未披露	超过1000款
MPS	是一家领先的国际半导体公司，在全球电源管理芯片市场处于领先位置	6.28亿美元	未披露
矽力	为全球少数能生产小封装、高压大电流之IC设计公司之一	3.49亿新台币	超过500款
韦尔股份	国内知名集成电路设计企业，同时也是国内主要半导体产品分销商之一	6.57亿元	超过950款
圣邦股份	国内高端模拟芯片的领先企业	5.51亿元	超过1400款
富满电子	国内知名集成电路设计企业	4.65亿元	超过400款
发行人	覆盖多家国内外知名消费电子品牌的模拟芯片设计企业，但在国际市场整体占有率较低	4.29亿元	500余款

注:上述表格数据系2019年度数据,其中国内外竞争对手数据来自于公开信息查询。

如果公司未能准确把握市场和行业发展趋势,持续快速地进行技术和产品开发,未能充分利用客户资源将技术转换为产品并持续提升市场地位,竞争优势有可能被削弱,从而对公司的经营业绩产生不利影响。

（二）客户集中风险

公司专注于模拟芯片的研发及销售,产品主要应用于手机、可穿戴设备等消费电子领域。根据IDC数据,2020年全球智能手机前五大品牌三星、华为、苹果、小米、VIVO的出货量占全球智能手机出货量的比重合计为71.3%,全球可穿戴设备前五大品牌苹果、小米、三星、华为、Fitbit的出货量市场占有率合计达到67.1%,下游手机、可穿戴设备等领域高度集中的市场格局使得公司客户集中度较高。

报告期各期,公司前五大客户的销售占比分别为87.35%、82.35%和77.26%。其中,公司对三星电子的销售金额分别为25,330.72万元、28,112.11万元及25,209.42万元，占比分别为73.56%、59.24%和46.44%。发行人报告期内的收入规模及业绩的变化与向三星电子等主要客户的销售变化息息相关。如果主要客户经营状况发生重大不利变化、采购需求大幅下降或调整采购策略,可能导致公司订单大幅下降,从而对公司经营业绩产生不利影响。

此外,在公司的前五大客户中,除与三星电子合作历程较长外,其他客户主要是近年才通过认证或大批量供应的客户。如果公司未及时根据客户需求开发新产品、连续多款新产品未能通过认证,可能影响合作基础或导致客户流失,从而对公司经营业绩产生不利影响。

（三）境外销售风险

公司客户主要为三星电子、客户A、小米、LG等国际消费电子品牌,公司根据客户要求,产品出口至中国香港、韩国、越南等地区,使得公司外销占比较高。报告期内,公司外销收入分别为26,822.18万元、36,117.54万元和37,911.41万元，占主营业务收入的比例分别为78.14%、76.24%和69.95%。

近年来,国际贸易摩擦不断升级,虽然公司未受到美国加征关税等政策的影响,但若未来贸易摩擦持续升级，三星、LG等海外客户以及部分国内品牌客户的海外工厂所在的国家或地区的监管政策、贸易政策等发生不利变化,对国内出口的芯片增加关税或限制交易,将对公司业务产生不利影响。

（四）产品受消费电子行业景气度影响较大的风险

公司产品主要包括电源转换芯片、电源防护芯片、显示驱动电路等电源管理芯片,以及智能组网延时管理单元、高精度霍尔芯片、信号链芯片等其他类芯片。除智能组网延时管理单元外,公司产品主要应用于以手机、可穿戴设备等为代表的消费电子领域。手机、可穿戴设备领域产品面向大众,受宏观经济发展、行业技术演变、产品迭代更新等因素影响较大,根据IDC数据,2017-2020年度全球智能出货量手机分别为14.62亿部、14.05亿部、13.71亿部和12.92亿部,可穿戴设备出货量分别为1.15亿部、1.72亿部、3.37亿部和4.45亿部,存在一定波动。若未来下游手机、可穿戴等消费电子领域景气度下降,可能导致下游手机、可穿戴设备的市场需求发生波动,继而对公司产品的销售产生不利影响。

（五）产品迭代风险

随着下游应用领域的扩大及应用场景的变化,公司需要根据技术发展趋势和客户需求变化持续进行研发和创新,通过产品和技术的先进性来保持竞争力。目前,公司的产品从研发、客户认证到批量供应大约需要6-12个月的时间,批量后产品大约可维持3-4年的销售期。报告期内,新产品的批量化销售通常会成为公司后续年度营业收入持续增长的重要推动力。如果公司无法持续进行技术创新和产品开发,将无法保持产品的正常迭代,将影响公司的市场竞争力,继而影响业绩的持续增长。

（六）研发失败风险

研发创新是集成电路企业最重要的经营活动之一。为保持核心竞争力,公司需要充分结合行业技术前沿趋势和手机、可穿戴设备等下游领域的需求持续研发。报告期内,公司研发支出分别为2,745.20万元、3,559.06万元及3,898.18万元,占营业收入比重分别为7.97%、7.50%及7.18%,保持相对稳定。随着业务规模和应用领域的扩大,公司将开展电源管理芯片及其他类芯片(如智能组网延时管理单元、信号链芯片等)在更多领域的应用和研发,研发投入可能持续加大。但由于产品研发需要投入大量资金和人力,耗时较长且存在一定的不确定性,如果出现公司产品研发未达预期或开发的新产品缺乏竞争力、推广不力等情形,公司将面临前期研发投入无法收回、持续竞争力被削弱的风险。

（七）存货跌价风险

公司主要根据客户的预计需求、上游产能情况、公司库存情况等制定采购和生产计划,并根据市场变化动态调整备货水平。由于芯片生产周期较长且上游供应商较为集中,在业务规模不断扩大和上游产能紧张的情况下,公司通常会加大备货,使得存货余额随着业务规模的不断扩大而增加。报告期各期末,公司存货账面价值分别为7,669.76万元、9,282.26万元和9,154.31万元，占流动资产的比例为24.59%、25.48%和23.10%，存货跌价准备率分别为19.10%、16.50%和18.07%。由于公司产品的下游应用领域以手机、可穿戴设备等应用领域为主,终端电子产品的更迭较快,如果未来因客户需求变化、公司未能准确判断下游需求等原因使得公司存货无法顺利销售,或出现市场竞争加剧、公司产品性能缺少竞争优势等使得产品价格大幅下跌,将存在进一步计提存货减值准备的风险。

（八）税收优惠、政府补助不能持续的风险

根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号）和《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2016]49号)规定,公司作为国家规划布局内重点集成电路设计企业可减按10%的税率缴纳企业所得税。报告期内,公司因符合国家规划布局内集成电路设计企业享受的所得税优惠分别为157.75万元、350.90万元和684.41万元，占利润总额的比例为6.04%、8.29%和9.75%。如果未来公司无法满足税收优惠政策要求或上述税收优惠政策发生变化,可能对公司的盈利状况产生一定影响。

报告期各期，公司计入当期损益的政府补助金额分别为766.99万元、542.39万元和949.32万元,占归属于母公司股东净利润的比例分别为30.22%、13.30%、14.18%。如果未来国家对集成电路行业和研发创新的支持力度减弱,政府补助的减少将对公司的利润水平产生一定影响。

（九）募集资金投资风险

公司本次募集资金主要用于高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目、高性能电源防护芯片研发及产业化项目、研发中心建设项目、发展储备项目建设,投资总额分别为17,889.96万元、17,036.17万元、8,403.56万元和18,000.00万元,其中,固定资产、无形资产投资合计13,783.32万元。本次募集资金投资项目实施后,固定资产折旧及无形资产摊销金额将增加,项目实施期间的研发费用性投入也将快速提升。其中,募投项目涉及购置固定资产金额合计10,902.07万元,根据募投项目的实施进度,并综合考虑涉及的固定资产所属类别和固定资产折旧政策进行测算，未来五年内新增固定资产各期折旧金额分别为756.08万元、1,803.19万元、2,168.70万元、1,638.04万元和818.55万元,具体如下:

单位:万元

项目	2021年度（实施期第一年）	2022年度（实施期第二年）	2023年度（实施期第三年）	2024年度	2025年度
高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目	158.59	433.63	577.84	496.70	290.01
高性能电源防护芯片研发及产业化项目	102.57	315.70	472.98	456.35	330.13
研发中心建设项目	494.92	1,053.86	1,117.88	684.98	198.41
折旧合计	756.08	1,803.19	2,168.70	1,638.04	818.55
2020年度利润总额	7,020.53	7,020.53	7,020.53	7,020.53	7,020.53
折旧占2020年度利润总额比例	10.77%	25.68%	30.89%	23.33%	11.66%

注1:根据固定资产购置时间安排,假设于当年半年度末购置完毕并开始计提折旧;

注2:募投项目购置固定资产主要为电子设备,根据公司会计政策,电子设备估计的经济使用年限为3年、预计的净残值率为5%。

因此,公司需要通过扩大销售规模和毛利来抵销折旧摊销、研发投入等导致的成本费用增加,但如出现下游市场环境发生不利变化、募投项目未能顺利研发新产品、发行人市场开拓不力等情形,新增的销售规模产生的毛利无法抵消募投项目建设期内的折旧、摊销及研发费用支出,将对公司的盈利能力产生不利影响。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2021年5月7日,中国证券监督管理委员会作出《关于同意无锡力芯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)1593号),同意公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)的注册申请。具体内容如下:

“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司股票上市已经上海证券交易所《关于无锡力芯微电子股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》([2021]267号文)批准。根据力芯微的申请,按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,上海证券交易所同意力芯微股票在科创板上市交易,力芯微A股总股本为6,400.0000万股,其中1,302.6658万股于2021年6月28日起上市交易,证券简称为“力芯微”,证券代码为“688601”。

二、公司股票上市的相关信息

（一）上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

（二）上市时间:2021年6月28日

（三）股票简称:力芯微,扩位简称:力芯微股份

（四）股票代码:688601

（五）本次公开发行后的总股本:6,400.0000万股

（六）本次公开发行的股票数量:1,600.0000万股,全部为公开发行新股

（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:1,302.6658万股

（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:5,097.3342万股

（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:240.0000万股,其中华泰力芯微家园1号科创板员工持股集合资产管理计划(发行人高级管理人员、核心员工为参与本次战略配售设立的资产管理计划)获配股票数量为160.0000万股,光大富尊投资有限公司(参与跟投的保荐机构依法设立的相关子公司)获配股票数量为80.0000万股。

（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限如下:

序号	发行前股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	限售期
1	无锡亿晶投资有限公司	27,730,000	57.77	36个月
2	无锡创业投资集团有限公司	6,120,000	12.75	12个月
3	无锡高新技术创业投资股份有限公司	3,880,000	8.08	12个月
4	永兴达控股集团有限公司	2,000,000	4.17	12个月
5	珠海横琴海捷汇富创业投资合伙企业(有限合伙)	1,980,000	4.13	12个月
6	上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)	1,400,000	2.92	36个月
7	上海淞银财富投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000	2.08	12个月
8	平阳温元创业投资合伙企业(有限合伙)	970,000	2.02	12个月
9	深圳国泰君安申易一期投资基金企业(有限合伙)	900,000	1.88	12个月
10	苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙)	870,000	1.81	36个月
11	平阳艾朋投资合伙企业(有限合伙)	500,000	1.04	12个月
12	珠海横琴海捷卓越股权投资合伙企业(有限合伙)	400,000	0.83	12个月
13	上海温纳联行投资合伙企业(有限合伙)	250,000	0.52	12个月
合计		48,000,000	100.00	-

（十一）本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:请参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。

（十二）本次上市股份的其他限售安排:

1、光大富尊投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

2、发行人高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的华泰力芯微家园1号科创板员工持股集合资产管理计划获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

3、本次发行中网下发行部分:公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。本次发行承诺限售6个月的账户数量为495个,对应的股份数量为57.3342万股,该等股票的锁定期为6个月,锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

（十三）股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（十四）上市保荐机构:光大证券股份有限公司

三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

发行人选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(一)款规定的市值财务指标:“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”作为其首次公开发行股票并在科创板上市的具体上市标准。

（二）公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

本公司本次公开发行1,600.0000万股人民币普通股(A股),发行价格为36.48元/股,发行后公司总股本为6,400.0000万股，由此计算发行市值为23.35亿元。公司2019年度、2020年度归属于母公司所有者的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为3,408.24万元、5,268.95万元;2020年,公司营业收入为54,283.67万元。满足《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条规定的上市标准中的“(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

综上,发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(一)款规定的市值及财务指标标准。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

中文名称	无锡力芯微电子股份有限公司
英文名称	Wuxi ETEK Microelectronics Co.,Ltd.
本次发行前注册资本	4,800万元人民币
法定代表人	袁敏民
有限公司成立日期	2002年5月28日
股份公司成立日期	2008年12月31日
公司住所	无锡新区新辉环路8号
经营范围	半导体集成电路及半导体分立器件的设计、加工、销售;软件开发;电子产品、仪器仪表、电气机械的销售;自营各类商品的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务	以电源管理类芯片主的模拟芯片的研发及销售
所属行业	根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”
联系电话	0510-85217779
传真号码	0510-80297981
互联网网址	http://www.etek.com.cn
电子信箱	maocl@etek.com.cn
信息披露和投资者关系管理部门	公司董事会秘书办公室
信息披露和投资者关系管理部门负责人	毛成烈
信息披露和投资者关系管理部门联系电话	0510-85217779

二、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东及实际控制

1、控股股东

公司控股股东为亿晶投资，持有公司2,773.00万股，占本次发行前公司总股本的57.77%。亿晶投资基本情况如下所示:

公司名称	无锡亿晶投资有限公司
法定代表人	袁敏民
成立时间	2002年1月21日
注册资本	742.2265万元
实收资本	742.2265万元
注册地	无锡市新吴区新辉环路8号
主要生产经营地	无锡市新吴区新辉环路8号
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

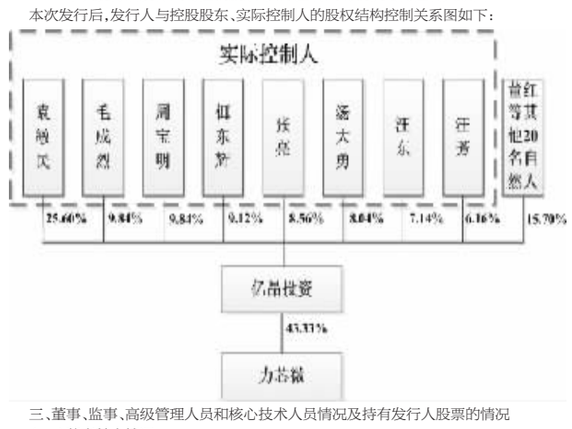
2、实际控制人

发行人的实际控制人为袁敏民、毛成烈、周宝明、佴东辉、张亮、汤大勇、汪东、汪芳,上述八人合计持有亿晶投资84.30%的股权,并通过亿晶投资间接持有发行人发行前股本总额的48.70%。实际控制人的相关信息如下表所示:

序号	姓名	国籍	永久境外居留权	身份证号码
1	袁敏民	中国	无	320211196502*******
2	毛成烈	中国	无	320211197011*******
3	周宝明	中国	无	320211196202*******
4	佴东辉	中国	无	510102196702******
5	张亮	中国	无	320106196702******
6	汤大勇	中国	无	320811197103*******
7	汪东	中国	无	410901197508******
8	汪芳	中国	无	320102197603*******

（二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

本次发行后,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:



三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况及持有发行人股票的情况

（一）董事基本情况

公司董事会由9名董事组成,其中包括3名独立董事。现任董事基本情况如下:

序号	姓名	职务	任期起止日期
1	袁敏民	董事长、总经理	2020年12月23日至2023年12月22日
2	毛成烈	董事、副总经理、董事会秘书	2020年12月23日至2023年12月22日
3	刘继斌	董事	2020年12月23日至2023年12月22日
4	郁鹏	董事	2020年12月23日至2023年12月22日
5	赵志东	董事	2020年12月23日至2023年12月22日
6	李明	董事	2020年12月23日至2023年12月22日
7	于燮康	独立董事	2020年12月23日至2021年12月27日
8	陈鹏	独立董事	2020年12月23日至2021年12月27日
9	姚王信	独立董事	2020年12月23日至2021年12月27日

（二）监事基本情况

公司监事会由3名成员组成,其中职工代表监事1名。现任监事基本情况如下:

序号	姓名	职务	任期起止日期
1	夏勇杰	监事会主席、设计经理	2020年12月23日至2023年12月22日
2	伍旻	监事、设计经理	2020年12月23日至2023年12月22日
3	王磊	监事	2020年12月23日至2023年12月22日

（三）高级管理人员基本情况

公司有高级管理人员6名。高级管理人员基本情况如下:

序号	姓名	职务	任期起止日期
1	袁敏民	董事长、总经理	2020年12月28日至2023年12月27日
2	毛成烈	董事、副总经理、董事会秘书	2020年12月28日至2023年12月27日
3	周宝明	副总经理	2020年12月28日至2023年12月27日
4	张亮	副总经理	2020年12月28日至2023年12月27日
5	汪东	副总经理、设计所所长	2020年12月28日至2023年12月27日
6	董红	财务负责人	2020年12月28日至2023年12月27日

（四）核心技术人员基本情况

公司共有9名核心技术人员,具体情况如下:

序号	姓名	职务
1	汤大勇	总工程师
2	汪东	副总经理,设计所所长
3	王国鹏	设计所副所长
4	吴相俊	设计所副所长
5	刘钰	设计所副所长
6	夏勇杰	监事会主席、设计经理
7	伍旻	监事、设计经理
8	石波	应用技术经理
9	孙思兵	设计经理

（五）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有发行人股票的情况

1、直接持股

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属均不存在直接持有公司股份的情况。

2、间接持股

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有公司股份的具体情况如下:

股东姓名	现任职务/亲属关系	持有亿晶投资股权		发行前间接持股比例(%)
		持股数量(万股)	持股比例(%)	
袁敏民	董事长、总经理	189.9975	25.60	14.79
毛成烈	董事、副总经理、董事会秘书	73.0477	9.84	5.69
周宝明	副总经理	73.0477	9.84	5.69
张亮	副总经理	63.5457	8.56	4.95
汤大勇	核心技术人员	59.6645	8.04	4.64
汪东	副总经理、核心技术人员	52.9731	7.14	4.12
王国鹏	核心技术人员	13.3778	1.80	1.04
吴相俊	核心技术人员	12.8711	1.73	1.00
刘钰	核心技术人员	9.5650	1.29	0.74
夏勇杰	监事会主席、核心技术人员	3.5123	0.47	0.27
石波	核心技术人员	3.5123	0.47	0.27
孙思兵	核心技术人员	3.1933	0.43	0.25
董红	财务负责人	3.1933	0.43	0.25
伍旻	监事、核心技术人员	2.7093	0.37	0.21

股东姓名	现任职务/亲属关系	持有永兴达股权		发行前间接持股比例(%)
		持股数量(万股)	持股比例(%)	
刘继斌	董事	600.00	1.95	0.08

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属的上述持股不存在质押或冻结的情况。

截至本上市公告书签署日,除上述情况外,其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其亲属未持有公司股份。

（六）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份限售情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份限售情况请参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。

（七）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司债券的情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在直接或间接持有公司债券的情况。

四、公司制定的股权激励计划、员工持股计划

截至本上市公告书签署日,公司不存在正在执行的对董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和其他员工实行的股权激励(如员工持股计划、限制性股票、股票期权)及其他制度安排。

五、发行人股本情况

（一）本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前,发行人总股本为4,800.00万股,本次公开发行1,600.0000万股,占发行后总股本的25.00%。

本次发行前后,发行人股本结构变动情况如下:

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
	数量(股)	占比	数量(股)	占比	
一、限售流通股					
无锡亿晶投资有限公司	27,730,000	57.77%	27,730,000	43.33%	36个月
无锡创业投资集团有限公司	6,120,000	12.75%	6,120,000	9.56%	12个月
无锡高新技术创业投资股份有限公司	3,880,000	8.08%	3,880,000	6.06%	12个月
永兴达控股集团有限公司	2,000,000	4.17%	2,000,000	3.13%	12个月
珠海横琴海捷汇富创业投资合伙企业(有限合伙)	1,980,000	4.13%	1,980,000	3.09%	12个月
上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)	1,400,000	2.92%	1,400,000	2.19%	36个月
上海淞银财富投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000	2.08%	1,000,000	1.56%	12个月
平阳温元创业投资合伙企业(有限合伙)	970,000	2.02%	970,000	1.52%	12个月
深圳国泰君安申易一期投资基金企业(有限合伙)	900,000	1.88%	900,000	1.41%	12个月
苏民投君信(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙)	870,000	1.81%	870,000	1.36%	36个月
平阳艾朋投资合伙企业(有限合伙)	500,000	1.04%	500,000	0.78%	12个月
珠海横琴海捷卓越股权投资合伙企业(有限合伙)	400,000	0.83%	400,000	0.63%	12个月
上海温纳联行投资合伙企业(有限合伙)	250,000	0.52%	250,000	0.39%	12个月
华泰力芯微家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	-	-	1,600,000	2.50%	12个月
光大富尊投资有限公司	-	-	800,000	1.25%	24个月
网下摇号抽签限售股	-	-	573,342	0.90%	6个月
小计	48,000,000	100%	50,973,342	79.65%	-
二、无限售流通股					
无限售条件的流通股	-	-	13,026,658	20.35%	-
合计	48,000,000	100%	64,000,000	100.00%	-

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异由四舍五入造成。

（二）本次发行后,前十名股东持股情况

本次发行后,公司前十名的股东持股情况如下:

序号	股东姓名/名称	持股数量(股)	持股比例	限售期限
1	无锡亿晶投资有限公司	27,730,000	43.33%	36个月
2	无锡创业投资集团有限公司	6,120,000	9.56%	12个月
3	无锡高新技术创业投资股份有限公司	3,880,000	6.06%	12个月
4	永兴达控股集团有限公司	2,000,000	3.13%	12个月
5	珠海横琴海捷汇富创业投资合伙企业(有限合伙)	1,980,000	3.09%	12个月
6	华泰力芯微家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	1,600,000	2.50%	24个月
7	上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)	1,400,000	2.19%	36个月
8	上海淞银财富投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000	1.56%	12个月
9	平阳温元创业投资合伙企业(有限合伙)	970,000	1.52%	12个月
10	深圳国泰君安申易一期投资基金企业(有限合伙)	900,000	1.41%	12个月
合计		47,580,000	74.35%	-

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异由四舍五入造成。

六、战略配售情况

发行人本次公开发行股票1,600.0000万股,发行股份占本次公开发行后公司股份总数的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次发行中,初始战略配售发行数量为240.0000万股，占本次发行数量的15.00%。最终战略配售数量为240.0000万股,占本次发行总数量的15.00%。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划构成,其中,跟投机构为光大富尊投资有限公司,发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为华泰力芯微家园1号科创板员工持股集合资产管理计划(以下简称“力芯微员工资管计划”)。

（一）保荐机构相关子公司跟投

保荐机构安排保荐机构依法设立并合法存续的另类投资子公司光大富尊投资有限公司参与本次发行战略配售,光大富尊投资有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定，光大富尊投资有限公司本次跟投获配股数为80.0000万股,占发行总数量的5%,跟投金额为2,918.40万元。限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

（二）发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划

2021年5月13日,发行人召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司高级管理人员与核心员工参与公司首次公开发行股票战略配售的议案》，同意发行人部分高级管理人员和核心员工设立专项资产管理计划参与发行人战略配售。前述专项资管计划获配的股票数量不超过首次公开发行股票数量的10%,且承诺获得本次配售的股票限售期限为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

力芯微员工资管计划的基本情况如下:

具体名称:华泰力芯微家园1号科创板员工持股集合资产管理计划

设立时间:2021年5月20日

备案